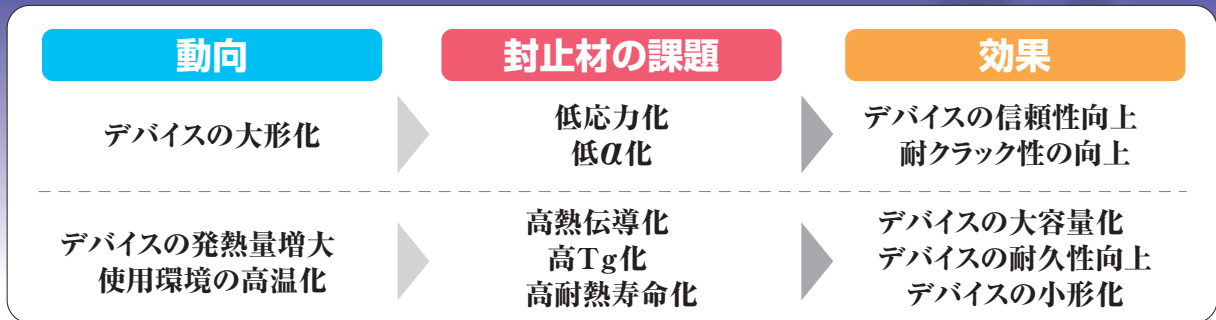


RYODEN KASEI

電気・電子機器用 液状封止材



お客様のビジネスに役立つ技術を当社は目指します。



モールドディング材 RLP-THM100

用途 モールドモータ、リアクトル、磁気コイル

項目	測定条件	単位	特性値
外観	目視(混合物)	—	白色~灰色
液タイプ	使用前混合	—	2液
粘度	25°C	Pa·s	260
	40°C		60
	80°C		5
ゲル化時間	130°C	sec	280
	140°C		150
	150°C		92
硬化条件	熱風加熱炉	°C×h	150×4
せん断接着能力	Fe製被着材 (JISG3101 SS400)	MPa	5.8
Tg	TMA法	°C	123
	DMA法 (tan δ ピーク)		144
線膨張係数 (α 1)	TMA法	ppm/°C	18.9
熱伝導率	室温 (25°C)	W/(m·K)	1.1

せん断接着強度: 試験片は、Fe製被着材 (JISG3101 SS400) に樹脂を12.5×25 mmの面積で塗布
※上表の数値は測定の一例であり保証値ではありません。

ポッティング材 RLP-P51

用途 ECU封止、車載用センサー、パワモジュール

項目	単位	特性値	
液特性	外観	—	黒色液状
	樹脂粘度 (25°C)	Pa·s	49
	比重	—	1.46
	ゲルタイム (120°C)	min	7
硬化物特性	硬度	ショアD	92
	せん断接着能力	MPa	36
	Tg (TMA法)	°C	95
	線膨張係数 (α 1)	ppm/°C	50
	体積抵抗率	Ω ·cm	6.5×10^{15}
硬化条件	°C×h	120×0.5	

せん断接着強度: 試験片は、Fe製被着材 (SPCC) に樹脂を5×25 mmの面積で塗布
※上表の数値は測定の一例であり保証値ではありません。

機能性接着剤 RLP-S2.0K

用途 電装品コイル接着

測定項目	単位	特性値	
粘度	Pa·s	25°C	250
		40°C	47
せん断接着強度 (室温 (25°C))	MPa	15	
Tg (TMA法)	°C	85	
線膨張係数 (α 1)	ppm/°C	18	
体積抵抗率	Ω ·cm	5.2×10^{15}	
熱伝導率	W/(m·K)	2.4	
硬化条件	°C×h	120×1	

せん断接着強度: 試験片は、Fe製被着材 (JISG3101 SS400) に樹脂を5×25 mmの面積で塗布
※上表の数値は測定の一例であり保証値ではありません。

ダイボンド材 V960-04

用途 半導体デバイス

項目	単位	条件 ^{※1}	特性値		
液特性	外観	—	白色		
	粘度	Pa·s	25°C	70	
	ゲル化時間	min	150°C	2	
	ポットライフ	d	25°C	3	
	シェルフライフ	d	$\leq -15^\circ\text{C}$	90	
硬化物特性	ダイシヤ強度	MPa	—	>15	
	ガラス転移温度	°C	TMA	158	
	硬化時の発生ガス	—	—	無し	
	不純物イオン濃度 ^{※2}	Na	ppm	—	<1.0
		CL	ppm	—	<10.0
	標準硬化条件 (オープン中)	min	150°C	30	
	塗布方法	—	—	スタンピング	

※1: 温度表記のない項目は常温測定です。 ※2: 不純物イオン濃度 (121°C/100%, 2amt 20h 抽出液中濃度です。
※上表の数値は測定値であり保証値ではありません。

未来を視つめる確かな技術

 菱電化成株式会社